

关于江苏长电科技股份有限公司
重大资产购买实施情况
之
独立财务顾问持续督导意见

(2016 年)

独立财务顾问



北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二零一七年五月

独立财务顾问声明

中国国际金融股份有限公司接受江苏长电科技股份有限公司的委托，担任其重大资产购买之独立财务顾问。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了本持续督导意见。

本持续督导意见不构成对江苏长电科技股份有限公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本持续督导意见出具的前提是：江苏长电科技股份有限公司向本独立财务顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料。江苏长电科技股份有限公司保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。

释义

在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：：

本核查意见	指	中国国际金融股份有限公司《关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问持续督导意见》
长电科技/上市公司	指	江苏长电科技股份有限公司
目标公司/星科金朋/ STATS ChipPAC	指	STATS ChipPAC Ltd.，该公司曾于新加坡证券交易所上市，目前已被长电科技私有化
本次收购/本次交易/ 本次要约收购/本次 重大资产收购	指	长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份
台湾子公司重组	指	星科金朋在新加坡设立一家新公司 Bloomeria Limited ，并将星科金朋下属两家台湾子公司的股权转由 Bloomeria Limited 持有；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Bloomeria 的股权及现金，从而剥离台湾子公司
Bloomeria	指	星科金朋为进行台湾子公司重组而设立的注册于新加坡的全资子公司 Bloomeria Limited
新潮集团	指	江苏新潮科技集团有限公司，本公司第一大股东
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
芯电半导体	指	芯电半导体(上海)有限公司，中芯国际的全资子公司
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
联合投资者	指	本次收购中与本公司进行联合投资的芯电半导体及产业基金
长电新科	指	长电科技与产业基金、芯电半导体为本次交易之目的在苏州工业园区设立的特殊目的公司苏州长电新科投资有限公司，即 HoldCo A
长电新朋	指	长电新科与产业基金为本次交易之目的在苏州工业园区设立的特殊目的公司苏州长电新朋投资有限公司，即 HoldCo B

JSCC	指	星科金朋半导体（江阴）有限公司，星科金朋江阴子公司
JSCK	指	JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED，注册地：韩国，长电国际全资子公司
要约人	指	长电新朋为本次交易之目的在新加坡设立的特殊目的公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.，即 BidCo
淡马锡	指	Temasek Holdings (Private) Limited，为星科金朋原控股股东的实际控制人
STSPL	指	星科金朋原控股股东 Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd
附生效条件的要约	指	本公司所控制的要约人向星科金朋发出的附生效条件的自愿性现金要约
正式要约	指	附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司及联合投资者为本次交易之目的设立的特殊目的公司对星科金朋所发出的自愿有条件现金要约，正式要约的条件如下：（1）有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持有、控制或即将收购的股份之和，占目标公司总股本的比例不低于 50%；（2）完成减资及台湾子公司重组；（3）目标公司于正式要约公告日启动永续证券的发行。
台湾子公司	指	星科金朋在正式要约宣告无条件之前拥有 52%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 与星科金朋拥有 100%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.
SCT 1	指	星科金朋在正式要约宣告无条件之前拥有 52%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation
SCT 3	指	星科金朋原拥有 100%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.
台湾投审会	指	台湾经济部投资审议委员会（IC）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

本独立财务顾问/独立财务顾问/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
新元	指	新加坡元

中国国际金融股份有限公司作为长电科技本次重大资产购买的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规和规定的要求，对本次重大资产购买的实施情况进行了持续督导，并经与长电科技法律顾问及审计师充分沟通后，出具独立财务顾问持续督导意见如下：

一、本次重大资产购买方案概述

1、要约收购的基本情况

联合收购方：江苏长电科技股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司

收购主体：JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.（即要约人）

交易标的：STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋）（不含台湾子公司）

交易对方：目标公司全体股东

收购方式：长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份。

收购对价：本次要约的对价以现金支付：每股星科金朋股票收购价格约为 0.46577 新元。

总交易对价：本次交易收购 100%股权的总对价为 7.8 亿美元，约合 10.26 亿新元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算），约合人民币 47.74 亿元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对人民币汇率中间价：1 美元折合 6.1205 人民币计算）。

2、台湾子公司重组的基本情况

鉴于台湾地区对于陆资企业投资台湾半导体相关行业企业有一定的政策限制，而本次要约收购的同时，若不进行台湾子公司重组，收购完成后目标公司的台湾子公司将被陆资企业所间接控制。为避免对本次要约收购的实施产生影响，经长电科技与目标公司及其控股股东协商，在本次要约收购的同时进行台湾子公司重组。具体方案如下：星科金朋持有 52% 股权的台湾子公司 SCT 1 向星科金朋收购其持有 100% 股权的台湾子公司 SCT 3，收购对价约为 1,500 万美元，收购后 SCT 3 成为 SCT 1 的全资子公司。星科金朋在新加坡设立一家新公司 Bloomeria，将 SCT 1 的 52% 的股权以 7,410 万美元的对价转让给 Bloomeria 持有，并获得 Bloomeria 向其发行的证券；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Bloomeria 的

全部股权和总计约 1,500 万美元的现金，从而剥离台湾子公司。星科金朋的股东可以选择获得现金或者 Bloomeria 的股份，但控股股东 STSPL 承诺选择接受 Bloomeria 的全部股票。Bloomeria 的股票不会在任何证券交易所上市。在台湾子公司重组的同时，SCT 3 归还欠星科金朋的 1.27 亿美元的债务；同时，为了确保星科金朋及台湾子公司在剥离后经营不受影响，2015 年 8 月，星科金朋与台湾子公司签署了《技术服务协议》和《过渡期服务协议》，星科金朋将依照约定向台湾子公司购买服务和产品，并约定了最低采购金额（Minimum Spend）。根据长电科技的相关公告，由于实际采购金额可能存在不确定性，星科金朋于 2015 年计提了“最低采购承诺”拨备。根据长电科技公告，2017 年 1 月，经协商双方达成一致，星科金朋最终向已剥离的台湾子公司补偿金额为 30,196,640 美元，并需缴纳 5% 的增值税。

3、星科金朋债务重组及发行永续证券

考虑到本次交易导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋需根据其银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组，即星科金朋在被要约收购后将根据其原有银行贷款及发行在外的债券的相关条款约定发出回购要约，通过星展银行提供的上限为 8.9 亿美元的过桥贷款用于回购，然后再由星展银行通过提供退出贷款及协助星科金朋进行其他债务融资方式偿还过桥贷款，进而完成债务替换。同时，为了配合上述债务重组并替换星科金朋现有的部分债务，星科金朋向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元，星科金朋控股股东 STSPL 承诺认购最高两亿美元的永续证券并按约定时间缴纳认购款项。长电科技已出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。上述担保经长电科技股东大会审议通过，并在永续证券发行后生效。

二、关于本次交易资产的交付或过户情况的核查

1、拟购买资产的股权过户情况

截至 2015 年 6 月 26 日，本次附生效条件的要约的生效条件已全部获得满足，要约人向星科金朋发出正式要约。

截至 2015 年 8 月 5 日，台湾子公司重组已完成，星科金朋永续债券已启动发行，且目标公司已有超过 50% 的股份（含 STSPL 所持有的 83.8% 的星科金朋股份）接受了本次要约，本次要约宣告为无条件。STSPL 接受本次要约后，有效接受要约的股份，占目标公司总股本（不含要约人及其关联方或代表发出要约之前所持有的股份）的比例不低于 90%。

据此，要约人有权并将根据新加坡市场相关规定，执行法定强制程序，收购剩余股权。本次要约收购以私有化目标公司为目的。

截至新加坡时间 8 月 27 日下午 5:30，本次要约收购期已截止。收购人已经完成部分已接纳要约股份的交割手续。

2015 年 10 月 12 日，要约人行使强制收购权利，并于 2015 年 10 月 15 日完成强制收购程序，就星科金朋的全部股份完成交割，星科金朋成为要约人的全资子公司。2015 年 10 月 19 日，星科金朋完成新加坡交易所退市。

经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产购买的标的公司股权已完成交割登记。

2、相关债权债务处理情况

要约收购前，星科金朋发行在外的优先票据主要为 2016 年 3 月 31 日到期、本金为 2 亿美元的债券（简称“2016 债券”）和 2018 年 3 月 20 日到期、本金为 6.115 亿美元的优先债券（简称“2018 债券”）。2015 年 8 月，星科金朋与星展银行签订了 8.9 亿美元的高级过桥贷款融资协议。过桥贷款的目的是用于星科金朋要约回购 2016 债券和 2018 债券；2015 年 9 月，星科金朋发出现金回购部分或全部 2016 债券和 2018 债券的要约，星科金朋从过桥贷款中提取了 5.38 亿美元，连同 2 亿美元永续债券募集资金一起进行债券回购。2016 年 4 月，星科金朋申请了退出贷款，对过桥贷款进行了偿还。截至本持续督导报告出具之日，星科金朋债务重组中过桥贷款偿还和新债务融资全部完成，债务重组过程也全部完成。

本次交易不涉及长电科技证券发行登记等相关事宜。

三、关于交易涉及方承诺的履行情况的核查

1、星科金朋原控股股东 STSPL 的承诺履行情况

在本次交易中，星科金朋控股股东 STSPL 出具的承诺及其履行情况如下：

1) 承诺以其现在持有的以及未来可能持有的全部星科金朋的股份在约定时间内接纳本次要约；

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。

2) 除了接受本次要约外，不得对全部或部分已持有的星科金朋股份进行出售、转移或任何其他处理；

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。

3) 无论法律是否允许，均不得撤回接受要约的承诺；

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。

4) 不会接受任何竞争要约, 无论该竞争要约价格是否高于本次交易的要约价格;

截至本持续督导报告出具之日, STSPL 已履行上述承诺。

5) 承诺在星科金朋审议台湾子公司重组的股东大会上投出赞成票;

截至本持续督导报告出具之日, STSPL 已履行上述承诺。

6) 承诺在星科金朋以减资的方式分派 Bloomeria 股权及现金时, 选择获得 Bloomeria 的股权;

截至本持续督导报告出具之日, STSPL 已履行上述承诺。根据 SCT1 的 2015 年年报披露, 其控股股东为 Bloomeria, 实际控制人为淡马锡。

7) 承诺在星科金朋审议根据永续证券条款修改公司章程的股东大会上投出赞成票;

截至本持续督导报告出具之日, STSPL 已履行上述承诺。

8) 承诺按股权比例认购永续证券, 并且在其他股东放弃认购的情况下, 承诺认购所有未被其他股东认购的部分, 并按约定时间缴付认购款, 即 STSPL 将认购最高 2 亿美元的永续证券。

截至本持续督导报告出具之日, STSPL 已履行上述承诺。上述 2 亿美元永续证券已完成发行, STSPL 已认购了所有未被其他股东认购的永续证券。

2、长电科技的承诺履行情况

本次交易中, 长电科技承诺将在目标公司股权正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和长电科技会计政策编制的目标公司财务报告和审计报告。

2015 年 10 月 15 日, 要约人完成强制收购程序, 并就星科金朋的全部股份完成交割, 星科金朋成为要约人的全资子公司; 2015 年 10 月 19 日, 星科金朋正式从新交所退市, 本次交易完成。长电科技已于 2016 年 1 月 16 日公告了《江苏长电科技股份有限公司已收购业务(STATS ChipPAC Ltd.及部分子公司)截至 2015 年 7 月 31 日止七个月期间、2014 年度及 2013 年度备考财务报表及审计报告》以及《江苏长电科技股份有限公司 2014 年度及截至 2015 年 7 月 31 日止七个月期间备考合并财务报表》。

此外, 本次交易中, 为了配合债务重组并替换原有的部分债务, 星科金朋发行了两亿美元的永续证券。长电科技已出具担保承诺, 若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券, 永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技, 长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。上述担保承诺已经长电科技股东大会批准。由于永续证券发行尚未满三年, 故上述承诺尚不需要长电科技履行。

3、新潮集团的承诺履行情况

在本次交易中，长电科技第一大股东新潮集团出具的承诺及其履行情况如下：

1) 新潮集团将促使长电科技在 2015 年 2 月底（或经双方协商同意延长后的时间）之前召开股东大会审议通过本次交易及相关事宜。

2) 在长电科技审议本次交易及相关事宜的股东大会上，新潮集团将投出赞成票。

截至本持续督导报告出具之日，新潮集团已履行上述承诺。

四、关于盈利预测实现情况的核查

在本次交易过程中，不涉及盈利预测、盈利预测承诺或减值测试的相关安排。

五、关于管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状的核查

1、公司总体经营情况

上市公司的主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。目前公司产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP、QFN/DFN、BGA/LGA、FCBGA/LGA、SiP、WLCSP、TSV、Copper Pillar Bumping、3D 封装、MEMS、Fan-out eWLB、POP、PiP 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、电源管理、汽车电子等电子整机和智能化领域。

上市公司主要经营模式为根据客户要求提供专业的集成电路、分立器件封装测试服务以及根据市场需求情况自行加工销售分立器件封装测试产品。

长电科技收购星科金朋后业务规模扩大，根据 IC Insights 报告，长电科技销售收入在 2016 年全球前 10 大委外封测厂排名第三。业务覆盖国际、国内全部高端客户，包括高通、博通、SanDisk、Marvell、海思、展讯、锐迪科等。

截至 2016 年年底，上市公司总资产 297.2 亿元人民币，同比增长 16.3%，2016 年实现营业收入 191.5 亿元人民币，较 2015 年增长 77.2%，归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元，较 2015 年增长 104.5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为 2.05 亿元。

2、公司各主营业务经营情况

2016 年度是长电科技收购星科金朋的第一个完整财年，上市公司面临星科金朋个别大客户订单大幅下降、全球市场小幅周期波动等因素引起的亏损和较大的资金链压力，但本次

收购使上市公司在高端封装技术能力方面获得较大突破，能够为高端客户提供领先的封装服务。2016 年，上市公司营业收入比上年同期增加 77.2%，主要原因系长电科技韩国子公司 JSCK 业务增长及上市公司合并星科金鹏 2016 年全年收入。上市公司主营业务分行业、分产品情况如下：

单位：人民币元

主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）
电子元器件	19,022,231,156.55	16,795,786,312.65	11.70
主营业务分产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
芯片封测	18,723,423,840.20	16,594,637,788.20	11.37
芯片销售	298,807,316.35	201,148,524.45	32.68
主营业务分地区情况			
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）
境内销售	3,283,077,953.41	2,652,070,715.11	19.22
境外销售	15,739,153,203.14	14,143,715,597.54	10.14

上市公司收购星科金朋后，产能覆盖了高中低各种集成电路封测范围，涉足各种半导体产品终端市场应用领域。长电科技拥有行业领先的高端封装技术能力（如 Fan-out eWLB、WLCSP、SiP、BUMP、PoP 等），能够为国际顶级客户和高端客户提供下世代领先的封装服务。其中 WLCSP、BUMP、晶圆级扇出封装（Fan-out eWLB）技术，是半导体行业增长前景较好的细分市场，能够在同一生产线无缝加工多种规格硅片，为晶圆级封装带来前所未有的灵活性和高性价比的封测服务；系统集成封装（SiP）技术，是新一代移动智能终端电路封测的主流技术，将推动公司未来业务增长。

尽管收购后上市公司的封装技术、产品种类都有显著提升，但 2016 年全年来看，欧

美市场增长乏力，星科金朋主要大客户业务需求有所下降，2016 年仍处于亏损状态。

本次收购后，上市公司正在逐步进行整合，并已收到一定成效，主要体现在以下方面：

1) 经营业绩扭亏为盈初见成效，2016 年第三季度以来营业收入稳步回升；2) 两大项目成功实施，其中 JSCK SiP 项目全年营收 23.68 亿元人民币并已实现单月盈利，Fan-out eWLB 项目顺利扩产；3) JSCC 于 2016 年 11 月顺利完成了第一批大规模设备搬迁；4) 交叉销售效果显现，中国和海外一批知名的集成电路设计公司订单同比大幅增长，同时全面导入上市公司旗下各工厂。

六、关于公司治理结构与运行情况的核查

上市公司董事会由九人组成，其中独立董事三人，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并已制定相关工作细则。2016 年度，董事会共召开了 12 次会议。

上市公司按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由三人组成，其中一人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

上市公司股东大会的召集、召开和表决按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，保证股东享有平等地位并能够行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。2016 年，上市公司共召开 4 次临时股东大会、1 次年度股东大会。

2016 年度，星科金朋的高级管理人员基本保持稳定，未发生较大变化。目前，星科金朋的高级管理人员包括：Han Byung Joon 先生、Woo Kwek Kiong 先生、Hal Lasky 先生、Cindy Palar 先生、Shim Il Kwon 先生、Kim Won Gyou 先生、Soh Lip Leong 先生。

本独立财务顾问经适当核查后认为：长电科技根据相关规定，持续规范、完善公司法人治理结构，加强信息披露。2016 年内，公司治理结构与运行情况基本良好。

七、关于与已公布的重组方案存在差异的其他事项的核查

本独立财务顾问经核查后认为：本次交易的当事各方已按照公布的重大资产收购方案履行各方责任和义务，未发现上市公司及其董事、监事和高级管理人员、控股股东存在损害上市公司利益的情况，未发现可能影响上市公司及当事各方履行承诺的其它情况。

八、其他事项

根据长电科技公告，公司于 2016 年 4 月 27 日召开的六届二次董事会、于 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。公司拟以发行股份方式购买产业基金持有的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权以及芯电半导体持有的长电新科 19.61% 股权；同时，公司拟向芯电半导体非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。2017 年 3 月 1 日，经中国证监会上市公司并购重组委 2017 年第 9 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。截至本持续督导报告出具之日，上述交易尚未获得中国证监会批文。

（本页无正文，为《关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问持续督导意见》之签署页）

主办人： 孙莹
孙莹

郑天
郑天

法定代表人（或授权代表）： 王晟
王晟

